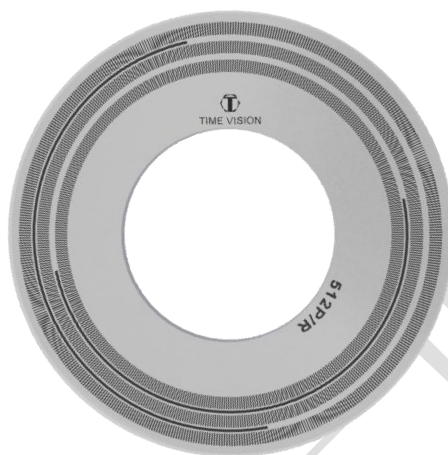


1. 码盘产品描述

该产品为 TVOET3309G 芯片的专用配套码盘。采用玻璃材质制造，具备优异的稳定性。其分辨率支持 510/512/480 等多种规格，可满足高精度应用需求。



2. 码盘尺寸参数

码盘设计整体参数如图 1 所示。

	Item	Parameter	Comments	[mm]	Tolerance
	H1	Outer Diameter		33.2	$\pm 100\mu\text{m}$
	H2	Inner Diameter		11.0	$+200\mu\text{m}$
	H3	Thickness		1.0	$\pm 100\mu\text{m}$
	H4	Radius of Chip Center	referred to origin	14.5	
	H5	Distance Pattern to Drill Hole		2.3	
	H6	Code Track Eccentricity	referred to center of inner hole	± 0.2	
	H7	Text1	readable on side of pattern	3309G	
	H8	Text2	readable on side of pattern	33-512	

图 1 整体参数

码盘设计细节参数如图 2 所示。

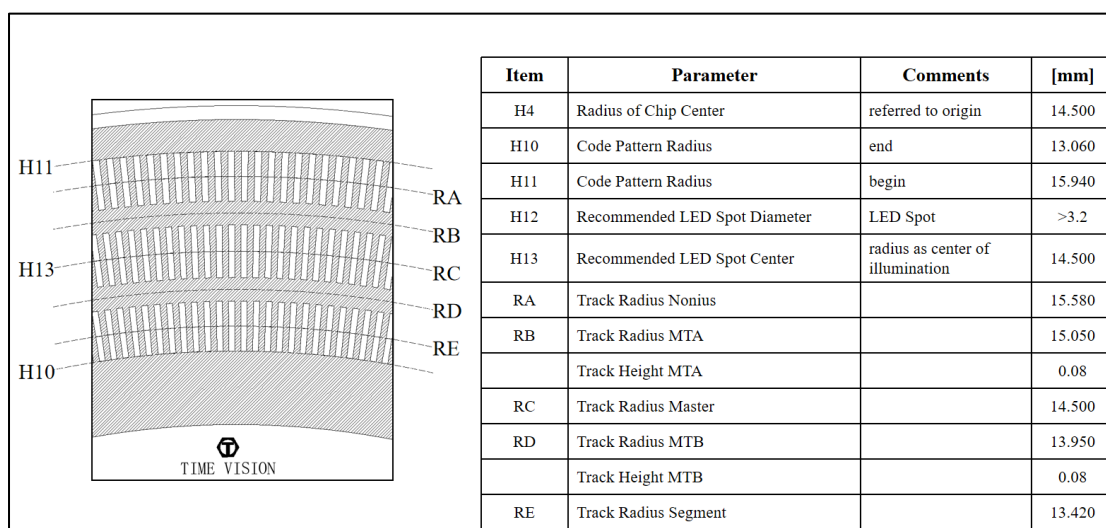


图 2 细节参数

3.码盘规格参数

名称	要求	名称	要求
材质	玻璃（日本 AGC 旭硝子）	码盘厚度	1.0±0.1 mm
镀层厚度	≥0.1 μm	外径	33.2±0.1 mm
真圆度	≤2 μm	内径	11.0±0.2mm
码盘平整度	≤3 μm	内孔偏心	≤0.05 mm
镀层光密度	3±0.4	线宽精度	≤1 μm
膨胀系数	≤9*10 ⁻⁶ /K	角度公差	±0.0005°
技术要求	1.表面无划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，不得有油污等脏污。 2.镀膜要求：码道区域镀层多余或缺失不得大于 0.5 码道；其他区域镀层多余或缺失不得大于 1*1mm		

4.版本信息

版本	时间	章节	修改内容	页面
V0.1	2025/11/5	全部	预发布版	全部